

2026年6月1日

各位

JX金属株式会社

台湾日鉱金属における半導体用スパッタリングターゲット加工ラインの自動化投資について

JX金属株式会社（社長：林陽一、以下「当社」）は、当社グループの台湾拠点である台湾日鉱金属股份有限公司（総経理：安武竜太、以下「台湾日鉱金属」）において、半導体用スパッタリングターゲット加工ラインの自動化投資を実施することを決定しましたので、お知らせいたします。

当社グループの半導体用スパッタリングターゲットは、最先端のロジックやメモリをはじめ各種半導体デバイスの製造に用いられ、業界トップのシェアを有しています。

台湾日鉱金属は半導体産業の集積地である台湾において、半導体用スパッタリングターゲットの下工程（加工工程）を担う主要拠点として重要な役割を果たしています。同拠点では顧客からの要請に機動的に対応できる供給体制を構築し信頼に応えるために継続的な設備増強を行っており、直近では2023年の3月に増強を発表した加工設備*が稼働を開始しています。

足元台湾においては、AIデータセンター向けのGPUなどの最先端ロジック半導体を中心とした半導体産業が活況を呈しており、当社グループの半導体用スパッタリングターゲットの需要も更なる増加が見込まれています。これに確実に対応していくためには、設備増強に加え、自動化による生産性の向上を通じた供給力の強化が不可欠であると考えています。

こうした背景のもと、当社グループが長年にわたる事業活動で培い国内外拠点で実績を重ねてきた、自動化設備やノウハウを、台湾日鉱金属へも展開することとしました。2026年5月から段階的に産業用ロボットや無人搬送車（AGV）などの最新鋭の設備の導入を進めていき、2027年6月から順次稼働を開始する予定です。これにより、台湾日鉱金属の加工能力は現行の約1.4倍となり、同工場の生産能力増大に寄与します。

なお、当社グループでは、AIデータセンター関連分野等における旺盛な需要を踏まえ、先端材料事業における複数製品について増強計画を準備しており、詳細につきましては、決定次第、順次お知らせいたします。

今後も当社グループは、「2040年JX金属グループ長期ビジョン」のもと、半導体をはじめとする先端技術の進化を支える先端材料の安定供給を通じて、社会の発展と革新に貢献してまいります。

以上

<参考>

*詳細は2023年3月29日プレスリリース「[台湾拠点における半導体用スパッタリングターゲットの生産能力の増強について](#)」をご覧ください。



台湾日鈇金属股份有限公司

台湾日鈇金属股份有限公司について（2026年6月1日現在）

会社名	台湾日鈇金属股份有限公司
所在地	桃園市龍潭区龍園一路 88 號
代表者	總經理：安武 竜太
資本金	63.5 百万台湾元
事業内容	半導体材料・情報通信材料の製造および販売、化学品等の工業製品の販売、金属スクラップおよび故銅等の集荷・販売